

Hochschule Aalen

Prof. Dr. Bürkle, 07361 576-2103
E-Mail: heinz-peter.buerkle@htw-aalen.de

Hochschule Albstadt-Sigmaringen

Prof. Dr. Gerlach, 07431 732-9155
E-Mail: gerlach@hs-alsig.de

Hochschule Esslingen

Prof. Dr. Lindermeir, 0711 397-4230
E-Mail: walter.lindermeir@hs-esslingen.de

Hochschule Furtwangen

Prof. Dr. Benyoucef, 07723 920-2342
E-Mail: benyoucef@hs-furtwangen.de

Hochschule Heilbronn

Prof. Dr. Gessler, 07940 1306-184
E-Mail: gessler@hs-heilbronn.de

Hochschule Karlsruhe

Prof. Dr. Ng, 0721 925-1520
E-Mail: herman-jalli.ng@h-ka.de

Hochschule Konstanz

Prof. Dr. Schick, 07531 206-657
E-Mail: cschick@htwg-konstanz.de

Hochschule Mannheim

Prof. Dr. Giehl, 0621 292-6860
E-Mail: j.giehl@hs-mannheim.de

Hochschule Offenburg

Prof. Dr. Mackensen, 0781 205-4770
E-Mail: elke.mackensen@hs-offenburg.de

Hochschule Pforzheim

Prof. Dr. Kesel, 07231 28-6567
E-Mail: frank.kesel@hs-pforzheim.de

Hochschule Ravensburg-Weingarten

Prof. Dr. Siggelkow, 0751 501-9633
E-Mail: siggelkow@hs-weingarten.de

Hochschule Reutlingen

Prof. Dr. Hennig, 07121 271-7129
E-Mail: eckhard.hennig@reutlingen-university.de

Hochschule Ulm

Prof. Dr. Terzis, 0731 502-8341
E-Mail: Anestis.Terzis@thu.de

Gerne erörtern wir mit Ihnen Wege der Zusammenarbeit.

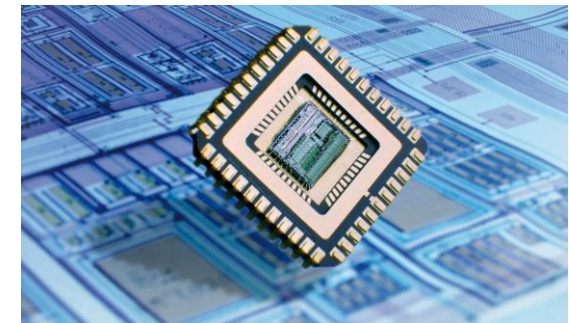
Für den Erstkontakt wenden Sie sich bitte an Ihren MPC-Ansprechpartner am nächstgelegenen Hochschulort.

Sie finden uns auch im Internet unter <http://www.mpc-gruppe.de>



MPC-GRUPPE

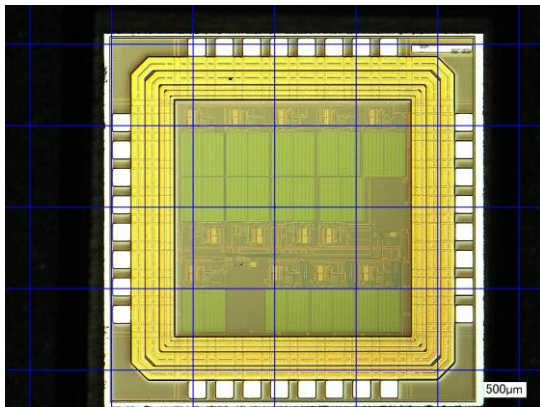
Hochschulen
in
Baden-Württemberg



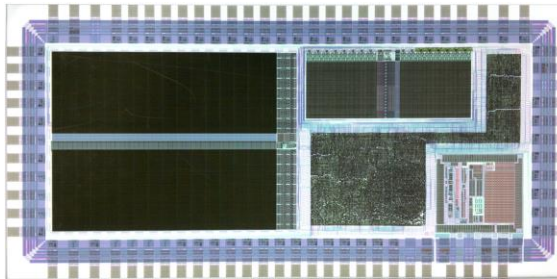
**Multi Projekt Chip
Gruppe**

**Ihr Partner bei der Entwicklung
integrierter Schaltungen**

Die Multi Projekt Chip Gruppe (MPC-Gruppe) ist eine Kooperation, an der sich rund 50 Professoren aus 13 baden-württembergischen Hochschulen beteiligen. Gemeinsam ist uns, dass wir alle das Spezialgebiet *Entwurf und Test monolithisch integrierter Schaltungen* vertreten. Wir vermitteln jährlich ca. 600 künftigen Ingenieuren Grundkenntnisse auf dem Gebiet der Schaltungsintegration. Ferner ebnen wir mit etwa 100 Bachelor-/Masterarbeiten pro Jahr vielen Unternehmen den Weg für spätere Produkte mit hoch-integrierten Bausteinen.



Verstärker, Filter 3. und 8. Ordnung in AMS S35D4 0.35 µm CMOS 4M/2P, Abmessung 2 x 2 mm²
 [N. Koetsier, F. Bohinsky, A. Zwick, M. Camoleze de Andrade, B. Vettermann, J. Giehl in ISSN 1868-9221, Band 55, S. 1-8, Herausgeber Hochschule Karlsruhe www.mpc-gruppe.de/de/workshopbaende.html].



Plot der Strukturen des ASIC-PDA V2, in einer UMC 0.18 µm CMOS 1P6M-Technologie, Abmessung des Chips 1,52 x 3,16 mm², 241 MIPS, Entwurf Benjamin Dusch u. a., Hochschule Offenburg.

Im Rahmen des Wissens- und Technologietransfers können wir für Unternehmen noch mehr tun und bieten unsere Hilfe bei der Entwicklung von ASIC's an:

- Beratung bei der Auswahl der geeigneten Integrationsform und Technologie
- Hilfe bei der Entwicklung von Entwurfsbaukästen und Bibliotheken
- Entwurf Ihrer integrierter Schaltungen sowie Beschaffung, Analyse und Spezifikation der Musterschaltungen
- Weiterbildung Ihrer Mitarbeiter

Wir benutzen Technologien und Bibliotheken bekannter Halbleiterhersteller und sind in der Lage, über EURO PRACTICE und CMP Muster in den nachstehenden Technologien zu vorteilhaften Konditionen fertigen zu lassen:

- AMS Austria Microsystems 350 und 180 nm CMOS
- Global Foundries 55 und 22 nm
- ON-Semiconductors 350 und 500 nm CMOS A/D Standardzellen und Full Custom
- TSMC 180 nm und 250 nm CMOS-Standardzellen
- UMC 250nm bis 45 nm Standardzellen und Full Custom
- **Alle über Europractice, FhG und CMP** erhältlichen Technologien
- FPGA-Designs für XILINX und ALTERA, GATE ARRAY Technologien div. Anbieter
- IP-Entwicklung (analog/digital) und Portierung auf Ziel-technologien